INTERFLUX® ELECTRONICS

LMPA™

- Low temp soldering alloy
- Higher reliability
- Environmentally friendly

LMPA™ Solder Alloys

SnBi basierte bleifreie Lotlegierungen mit niedrigem Schmelzpunkt

Patent Pending

RoHS compliant

Beschreibung

LMPA™ Solder alloys sind Lotlegierungen von hoher Reinheit mit niedrigem Schmelzpunkt.

Sie geben sehr wenig Krätzenbildung in Wellenlötmaschinen ohne Stickstoff.

Eine Schicht die aussieht wie Krätze kann an der Oberflläche des Lötbads gebildet werden. Dies sind keine Krätze aber Legierung in der Pastenphase. Die Schicht nicht entfernen, sie bleibt stabil.

Der Einsatz von LMPA™-Oil ist empfehlenswert für die Erstbefüllung und Wartung.

In Selektivlötanlagen wird der Einsatz von Stickstoff empfohlen.

Für Multiwelle Selektivlötanlagen ist es empfehlenswert die Düsen ständig mit Lot zu überfließen.

Keine Pb-haltige Oberflächen löten.

Die **LMPA™** Legierungen lösen viel weniger Cu von der Leiterplatte ab als Sn(Ag)Cu Legierungen.

Neben dem Einsatz im Wellen– und Selektivlöten sind die Legierungen auch erhältlich als Lotpaste für das Reflowlöten.

Die LMPA™ Legierungen haben verbesserte mechanische Eigenschaften gegenüber SnBi(Ag) Legierungen.

Damit sind sie die perfekte Ersatzlegierungen für viele Elektronikanwendungen die heute mit Sn(Ag)Cu Legierungen gelötet werden.

Der niedrige Schmelzpunkt erlaubt niedrigere Lötbadtemperaturen und eine kürzere und niedrigere Vorheizung

Das ergibt einen reduzierten energieverbrauch und niedrigere Kosten als auch erhöhte Fertigungskapazität und Produktionsgeschwindigkeiten.

Leiterplatte und Bauteile empfinden weniger Stress, was die Alterung reduziert und die Lebensdauer der elektronischen Baugruppe verlängert.

Eigenschaften

- Schneller Durchstieg
- Reduziertes Ablegieren von Cu der Leiterplatte
- Reduzierte Fertigungskosten
- Erhöhte Fertigungskapazität
- Reduzierter thermischer Stress
- Erhöhte Lebensdauer der Elektronik

Abgebildetes Produkt kann vom gelieferten Produkt abweichen

S.A. INTERFLUX® ELECTRONICS N.V - Eddastraat 51 - BE-9042 Gent - Belgium
tel.: +32 9251 49 59 - fax.: +32 9251.4970
www.interflux.com - Info@interflux.com

ISO 9001

Befüllung eines Tiegels

Wenn das Lot in einem Tiegel gewechselt wird für das LMPA™-Q Lot, ist es sehr wichtig das Alles sehr gut gereinigt wird von Rückständen und Oxiden der alten Legierung bevor das LMPA™-Q Lot eingefüllt wird.

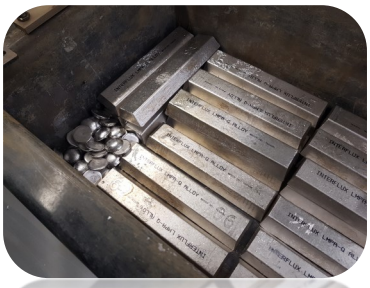
→ Den Thermofüller der die Temperatur des Tiegels regelt ohne Beschädigung entfernen und in Kontakt lassen mit dem flüssigen Lot während der Leerung und Befüllung. Nachher zurück in der richtigen Position montieren.

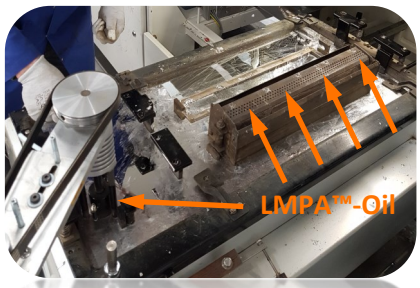
→ Pumpen, Pumpengehäusen, Düsen, Kanäle,...entfernen und gründlich reinigen.

→ Sicher stellen dass alle Oxiden so gut wie möglich entfernt sind vom Tiegel und seinen Teilen. Rückstände von bleifreien Legierungen können gelöst werden vom LMPA™-Q Lot und an der Oberfläche kommen, was zu schmutzige Leiterplatten führen kann.

Nach dem Befüllen eines Wellenlöttiegels mit LMPA™-Q , ein wenig **LMPA™-Oil** an die Pumpenachsen und die Lötdüsen anbringen und anschließend die Wellen etwa 15Min laufen lassen. Eine Rauch- und Geruchbildung ist möglich, Absaugung benützen.

Eine gute initiale Temperatureinstellung für das Wellenlöten ist 230°C, für das Selektivlöten 240°C.





Unterstützung und Dokumente zur Unterstützung bei der Prozesseinstellung sind verfügbar über: td@interflux.com

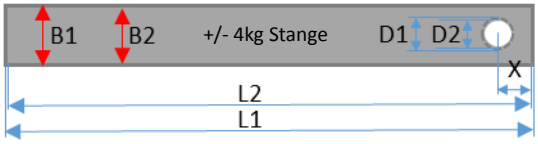
S.A. INTERFLUX® ELECTRONICS N.V - Eddastraat 51 - BE-9042 Gent - Belgium
tel.: +32 9251 49 59 - fax.: +32 9251.4970
www.interflux.com - Info@interflux.com

Sicherheit

Bitte immer das Sicherheitsdatenblatt des Produktes lesen.

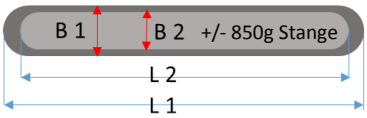
Verfügbarkeit

Legierung	Schmelzpunkt	Verpackung (Siehe Bilder S1)
LMPA™-Q	139°C-176°C	• +/- 4kg Stange mit Öse (pro Stück) +/- B1:51mm/B2:46mm X H:21mm X L1:516mm/L2:513mm +/- D1: 22mm/D2: 17mm X: 33mm



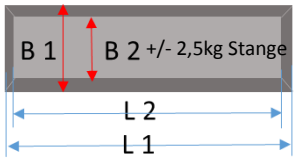
- +/- 850g Stangen in 20kg Dose

  +/- B1:21,5mm/B2:19mm X H:18mm X L 1:330mm/L2:325mm



- +/- 2,5kg Stangen in 18,5kg Dose

  +/- B1:65mm/B2:42mm X H:25mm X L 1:260mm/L2:250mm



- `Stones´ in 2,5kg Behälter +/- ø 37mm x 15mm
- 2mm voller Draht 2kg auf 4kg Spule
- 3mm voller Draht 4kg auf 4kg Spule
- +/- 52gr Stäbchen in 15kg Dose ø 5mm x +/- 320mm
- 1mm voller Draht 30 X 20cm (+/-0,5cm) in einem Rohr

Handelsname : LMPA™ -Q SOLDER ALLOYS

Bemerkung

LMPA™ist eine Handelsmarke (trade mark) von Interflux® Electronics N.V.

LMPA™ Legierungen unterliegen ein angemeldetes Patent und sind intellektuelles Eigentum von Interflux® Electronics N.V.

Haftungsausschluss

Diese Angaben beschreiben ausschließend die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stützen sich nach bestem Wissen auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Da Interflux® Electronics N.V. die vielen Möglichkeiten, unter denen die oben genannten Produkte eingesetzt werden können, weder kontrollieren, noch beeinflussen kann, kann keine Garantie über die Verwendbarkeit gegeben werden. Die Anwender sind jeweils verpflichtet, Tests zur Verwendbarkeit der Produkte für den jeweiligen Anwendungsfall in der eigenen Fertigungsumgebung durchzuführen. Die Daten des oben angegebenen Produktes stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des Produktes im Sinne von Haftungs- bzw. Gewährleistungsvorschriften dar und erfolgen unverbindlich.

Copyright:

INTERFLUX® ELECTRONICS N.V.

www.interflux.com/de

S.A. INTERFLUX® ELECTRONICS N.V - Eddastraat 51 - BE-9042 Gent - Belgium
tel.: +32 9251 49 59 - fax.: +32 9251.4970
www.interflux.com - Info@interflux.com